证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2026-026

天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年3月18日（星期三）下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2026年3月11日（星期三）至3月17日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱jhtdesign@jht-design.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年3月11日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，以及2025年年度利润分配情况，公司计划于2026年3月18日（星期三）15:00-16:00举行2025年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标、2025年度利润分配及资本公积转增股本方案等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年3月18日（星期三）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理崔学峰先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生、财务总监黄洁女士和独立董事孙晓伟先生等（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年3月18日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年3月11日（星期三）至3月17日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jhtdesign@jht-design.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：021-52277906

邮箱：jhtdesign@jht-design.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2026年3月11日

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2026-019

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于2026年3月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月28日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事，会议补充通知分别于2026年3月6日、2026年3月9日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于＜公司2025年年度报告＞及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年年度报告》《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于＜公司2025年度总经理工作报告＞的议案》

本公司总经理崔学峰先生代表公司管理团队，对2025年度公司整体运营情况进行了总结，对公司未来的发展进行了讨论与分析，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

（三）审议通过《关于＜公司2025年度董事会工作报告＞的议案》

本公司董事长崔学峰先生代表公司全体董事，对2025年度董事会履行职责的情况以及公司整体运营情况进行了总结，对公司未来的发展进行了讨论与分析，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司2025年度任职的独立董事向董事会提交了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度独立董事述职报告（孙晓伟）》《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度独立董事述职报告（李治国）》《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度独立董事述职报告（石建宾）》。

（四）逐项审议通过《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、董事所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会拟定了《公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案》。

2026年度，公司董事薪酬同岗位薪酬，董事除岗位薪酬外，不再另行发放董事薪酬，独立董事领取固定津贴，高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，具体情况如下：

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
4.01	《关于公司董事长兼总经理崔学峰先生2026年度薪酬方案的议案》	2026年度，公司董事薪酬同岗位薪酬，董事除岗位薪酬外，不再另行发放董事薪酬。岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	8	0	0	1（其中关联董事崔学峰先生回避表决）
4.02	《关于公司董事兼副总经理龙波先生2026年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1（其中关联董事龙波先生回避表决）
4.03	《关于公司职工代表董事仇葳先生2026年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1（其中关联董事仇葳先生回避表决）
4.04	《关于公司董事黄文强先生2026年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1（其中关联董事黄文强先生回避表决）
4.05	《关于公司董事冯思诚先生2026年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1（其中关联董事冯思诚先生回避表决）
4.06	《关于公司董事吴华先生2026年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1（其中关联董事吴华先生回避表决）
4.07	《关于公司独立董事孙晓伟先生2026年度薪酬方案的议案》	领取固定津贴，2026年度津贴标准为人民币8万元（税前），按月平均发放。	8	0	0	1（其中关联董事孙晓伟先生回避表决）
4.08	《关于公司独立董事李治国先生2026年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1（其中关联董事李治国先生回避表决）
4.09	《关于公司独立董事石建宾先生2026年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1（其中关联董事石建宾先生回避表决）
4.10	《关于公司董事会秘书兼副总经理刘海龙先生2026年度薪酬方案的议案》	公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	9	0	0	0
4.11	《关于公司财务总监黄洁女士2026年度薪酬方案的议案》		9	0	0	0

以上子议案均已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

以上子议案均获通过。

以上第1-9项子议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于＜公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规及规章制度的要求，董事会编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

（六）审议通过《关于＜公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

本公司审计委员会主任孙晓伟先生代表审计委员会全体委员，对2025年度审计委员会履行职责的情况进行了总结，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（七）审议通过《关于＜公司董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见＞的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，董事会对公司独立董事的独立性进行了核查：经核查独立董事孙晓伟先生、李治国先生、石建宾先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（八）审议通过《关于＜公司2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025年的内部控制有效性进行了评价，并出具了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司2025年度外部审计机构，鉴于其服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘容诚所作为公司2026年度外部审计机构，负责公司2026年度财务报告审计及内部控制审计，聘期为一年。公司聘任容诚所的审计费用由公司按照公平合理的原则与容诚所协商确定。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于续聘2026年度外部审计机构的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计29,553,770.27元。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

（十一）审议通过《关于2025年度利润分配方案并修订＜公司章程＞的议案》

经容诚所审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润176,525,276.68元，其中母公司实现净利润190,126,272.31元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积金后截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为621,360,576.53元，资本公积余额为913,289,420.01元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，具体方案如下：

1、现金分红：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税）。截至2026年3月9日公司总股本60,000,000股，公司拟合计派发的现金分红总金额为22,800,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例12.92%。

2、资本公积转增股本：公司拟向全体股东以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股。截至2026年3月9日，公司总股本为60,000,000股，本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为87,000,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过"资本公积——股本溢价"科目进行转增。

如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变，相应调整现金分红、转增股份金额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。

本次利润分配方案实施后，公司的注册资本和股本将发生变更，因此对《公司章程》里有关注册资本和股本的相应条款以2025年度利润分配方案实施后的实际情况进行修订。除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-023）及《天津金海通半导体设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于增加预计2026年度日常关联交易的议案》

为满足公司日常经营发展需要，公司拟新增与关联方南通华达微电子集团股份有限公司的日常关联交易事项，交易内容主要为公司向关联方出售半导体测试分选机及相关备品备件，本次预计新增日常关联交易金额合计不超过2,000万元，公司2026年度日常关联交易预计金额从17,440万元上升至19,440万元。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（其中关联董事吴华先生回避表决）。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于增加预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

（十三）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年3月31日召开公司2025年年度股东会，审议如下议案：

序号	审议事项
1.00	《关于＜公司2025年年度报告＞及其摘要的议案》
2.00	《关于＜公司2025年年度董事会工作报告＞的议案》
3.00	《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
3.01	《关于公司董事长兼总经理崔学峰先生2026年度薪酬方案的议案》
3.02	《关于公司董事兼副总经理龙波先生2026年度薪酬方案的议案》
3.03	《关于公司职工代表董事仇葳先生2026年度薪酬方案的议案》
3.04	《关于公司董事黄文强先生2026年度薪酬方案的议案》
3.05	《关于公司董事冯思诚先生2026年度薪酬方案的议案》
3.06	《关于公司董事吴华先生2026年度薪酬方案的议案》
3.07	《关于公司独立董事孙晓伟先生2026年度薪酬方案的议案》
3.08	《关于公司独立董事李治国先生2026年度薪酬方案的议案》
3.09	《关于公司独立董事石建宾先生2026年度薪酬方案的议案》
4.00	《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》
5.00	《关于2025年度利润分配方案并修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2026年3月11日

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2026-021

天津金海通半导体设备股份有限公司关于续聘2026年度外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）

●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为2026年度外部审计机构，负责公司2026年度财务报告审计及内部控制审计。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988年8月	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26		
首席合伙人	刘惟	上年末合伙人数量	233人
2025年末执业人员数量	注册会计师		1507人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		856人
2024年业务收入	业务收入总额	251,025.80万元	
	审计业务收入	234,862.94万元	
	证券期货业务收入	123,764.58万元	
上市公司2024年年报审计情况	客户家数	518家	
	审计收费总额	62,047.52万元	
	涉及主要行业	客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。	
本公司同行业上市公司审计客户家数		383家	

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案［(2021)京74民初111号］作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称"华普天健咨询"）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在容诚会计师事务所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字注册会计师	蔡如笑	2013年	2011年	2019年	2024年	近三年为5家上市公司提供年报审计等证券服务业务
签字注册会计师	詹湛湛	2018年	2016年	2019年	2025年	近三年为2家上市公司提供年报审计等证券服务业务
质量复核人	潘汝彬	2007年	2007年	2019年	2022年	近三年签署或复核过多家上市公司审计报告

2.项目成员的诚信记录和独立性情况

项目合伙人蔡如笑、项目质量复核人潘汝彬近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师詹湛湛于2023年被厦门证监局采取行政监管措施1次。除此外，近三年未再因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。具体情况详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	詹湛湛	2023年4月25日	行政监管措施	厦门证监局	弘信电子年报审计出具警示函

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度审计费用为75万元，其中年报审计费用为60万元，内控审计费用为15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第十八次会议于2026年3月9日召开。公司审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了核查，并对其2025年度的审计工作进行了总结，认为容诚会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。容诚会计师事务所在为公司提供2025年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。容诚会计师事务所出具的公司2025年度审计报告客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第二十六次会议于2026年3月10日召开，会议审议通过了《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所为2026年度外部审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和2026年度内部控制审计服务，并同意将此议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2026年3月11日

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2026-027

天津金海通半导体设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案并修订＜公司章程＞的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.50股。截至2026年3月10日，公司总股本为60,000,000股，本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为87,000,000股。上述转增方案将于公司2025年年度股东会审议通过后实施。上述转增方案实施完毕后，公司总股本将由60,000,000股变更为87,000,000股，公司注册资本将由人民币60,000,000元变更为87,000,000元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-023）。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

由于公司总股本及注册资本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行如下修订：

修订前编号	修订前内容	修订后编号	修订后内容
第五条	公司注册资本为人民币6,000万元。	第五条	公司注册资本为人民币8,700万元。
第二十条	公司股份总数为6,000万股，全部为普通股。	第二十条	公司股份总数为8,700万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，其余条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理上述章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2026年3月11日

公司代码：603061　　公司简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、现金分红：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税）。截至2026年3月10日公司总股本60,000,000股，公司拟合计派发的现金分红总金额为22,800,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例12.92%。

2、资本公积转增股本：公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股。截至2026年3月10日，公司总股本为60,000,000股，本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为87,000,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过"资本公积——股本溢价"科目进行转增。

如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变，相应调整现金分红、转增股份总额，具体调整情况将另行公告，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。

本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金海通	603061	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海龙	蔡亚茹
联系地址	上海市青浦区嘉松中路2188号	上海市青浦区嘉松中路2188号
电话	021-52277906	021-52277906
传真	022-89129719	022-89129719
电子信箱	jhtdesign@jht-design.com	jhtdesign@jht-design.com

2、报告期公司主要业务简介

（1）所属行业

公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备，根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T 0020—2024），隶属于专用设备制造业（行业代码：C35）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），隶属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造（行业代码：C3562）细分子行业。

（2）集成电路行业发展情况

①集成电路行业简介

半导体本质是一种导电性可受控制、介于绝缘体至导体之间的材料。从产业视角，半导体产业是围绕半导体包括材料、性能、应用等，发挥其优势进行科学研究、技术开发、功能设计、生产制造、集成应用与系统实施的全体系的产业；从环节视角，半导体产业包括半导体材料研发与生产、半导体装备与工具的生产制造、半导体产品规划设计、半导体产品的生产及其全体系；从功能视角，半导体包括集成电路和分立器件。集成电路是半导体产业的核心，也是信息产业的基础和核心。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，是计算机、家用电器、消费电子、工业自动化、通信、汽车电子、航天等诸多产业发展的基础，也是改造和提升传统产业的核心技术。按其功能、结构的不同，集成电路可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数模混合集成电路等。集成电路产业链主要包含芯片设计、晶圆制造、封装测试等。

公司的主要产品为集成电路行业中封装测试用的测试分选机，主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装测试。集成电路测试设备主要包括测试机、分选机和探针台等。测试机是检测芯片功能和性能的专用设备，分选机和探针台是分别将被测的芯片或晶圆与测试机的功能模块连接起来并实现批量自动化测试的专用设备。在晶圆检测环节，主要使用的测试设备为测试机和探针台，而在芯片设计验证、成品测试环节，主要使用的测试设备为测试机和分选机。

②集成电路专用设备行业简介

专用设备制造业是集成电路的基础产业和重要支撑，是完成晶圆制造和封装测试环节的基础，是实现集成电路技术进步的关键，在集成电路产业中占有极为重要的地位。集成电路生产线投资中设备投资占比较大，价值量较高。专用设备主要包含前道工序晶圆制造环节所需的光刻机、化学气相淀积（CVD）设备、刻蚀机、离子注入机、表面处理设备等；后道工序封装测试环节所需的切割减薄设备、度量缺陷检测设备、键合封装设备等；测试环节所需的测试机、分选机、探针台等。在晶圆制造环节使用的设备一般被称为前道工艺设备，在封测环节使用的一般被称为后道工艺设备。这些设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术，具有技术含量高、制造难度大、设备价值高等特点。

③行业发展情况

公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征，这与国际贸易形势、下游应用市场需求波动以及国家产业政策等因素均存在一定的相关性。

在技术迭代、需求提升、场景渗透等因素的多重驱动下，2025年全球半导体行业延续增长态势，先进封装、AI及高性能计算等需求的增长给半导体设备带来广阔的市场空间。半导体行业协会（SIA）数据显示，2025年全球半导体销售额达到7,917亿美元，较2024年同比增长25.6%，创历史新高。此前世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2025年全球半导体市场规模预计同比增长22.5%。上述驱动因素动能的持续释放，将推动未来几年全球半导体行业持续快速发展。

特别是随着先进封装、AI算力芯片等的发展，相关芯片测试的复杂度在攀升，芯片测试总耗时大幅提高，对高端测试资源的需求在快速增加；与此同时，相关芯片的测试在温度控制、热管理效率及动态适配能力等方面，对半导体测试分选设备提出了更高的要求。半导体测试设备公司已进入快速发展新阶段。

未来，集成电路产业将继续向更具精细化的模式发展。随着集成电路产业进一步精细化分工，为确保产品质量、生产效率和生产稳定性，半导体测试设备企业需要与集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业经过长时间的协作、磨合，提供符合客户使用习惯和生产标准的定制化测试方案开发，产业链协同效应将构筑行业新壁垒。同时，测试任务的复杂性对分选机设备不断提出更高要求，测试分选机设备将呈现高效率、高稳定性、柔性化及多功能的发展趋势。

（3）公司主营业务情况

自成立以来，公司一直专注于全球半导体芯片测试设备领域，同时致力于以高端智能装备核心技术助力我国半导体行业发展，以其自主研发的测试分选机产品加快半导体测试设备的进口替代。

公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司的产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。

公司产品集成电路测试分选机在客户公司（半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业、芯片设计公司等）所分选的芯片涵盖汽车电子、消费电子、智能互联、5G、人工智能等领域中应用的芯片（公司产品应用于某类芯片测试分选的具体情况系客户公司经营行为）。

（4）公司主要产品介绍

公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为EXCEED-6000系列、EXCEED-8000系列、EXCEED-9000系列、SUMMIT系列、COLLIE系列等不同系列的测试分选机。

公司产品测试分选机涉及到光学、机械、电气一体化的创新集成，可以精准模拟芯片真实使用环境，并实现多工位并行测试，其UPH可达20,000颗，Jam rate低于1/200,000，可测试芯片尺寸范围可涵盖2*2mm至125*170mm，可模拟最低-55℃、最高200℃等各种极端温度环境。

（5）公司主要经营模式

①盈利模式

公司为客户提供集成电路测试分选